

Title (en)

Method and device for removing contaminants from surfaces contaminated by a liquid

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zum Entfernen von Verunreinigungen von mit Flüssigkeit kontaminierten Oberflächen

Title (fr)

Procédé et dispositif pour enlever des contaminants de surfaces contaminées par un liquide

Publication

**EP 1101542 A2 20010523 (DE)**

Application

**EP 00123293 A 20001027**

Priority

DE 19955066 A 19991115

Abstract (en)

The cleaning process involves cooling a wiping element (3) which moves relative to the surface (2a) to be cleaned while in contact with it. Fluid (5) in contact with brushes becomes softer and at the same time more viscous, so that the particles (4) it contains remain stuck to the brushes. the surface of the workpiece can also be warmed.

Abstract (de)

Zum Entfernen von Verunreinigungen, insbesondere von Flüssigkeiten (5) und/oder Partikeln (4) von mit Flüssigkeit (5) kontaminierten oder benetzten Oberflächen von insbesondere plattenförmigen Werkstücken (2) mittels wenigstens eines Wischelementes (3) wird das gegenüber der zu reinigenden Oberfläche (2a) relativ bewegte und diese Oberfläche (2a) berührende Wischelement (3) abgekühlt, so daß die mit diesem Wischelement (3) und daran bevorzugt vorgesehenen Borsten (8) in Berührung kommende Flüssigkeit (5) eine höhere Zähigkeit und Viskosität annimmt oder sogar erstarrt und dadurch zusammen mit den in der Flüssigkeit (5) enthaltenen Partikeln (4) an dem Wischelement (3) oder seinen Borsten (8) haften bleibt. Dieses Reinigungsprinzip kann durch eine in Vorschubrichtung vor dem oder den Wischelementen (3) erfolgende Erwärmung an der Oberfläche des Werkstückes (2) unterstützt und beeinflußt werden. <IMAGE>

IPC 1-7

**B08B 1/02**; **B08B 7/00**

IPC 8 full level

**B08B 1/20** (2024.01); **B08B 5/02** (2006.01); **B08B 7/00** (2006.01); **F26B 5/14** (2006.01); **B21B 45/02** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B08B 1/20** (2024.01 - EP US); **B08B 1/30** (2024.01 - EP US); **B08B 1/50** (2024.01 - US); **B08B 1/52** (2024.01 - EP); **B08B 1/54** (2024.01 - EP); **B08B 5/02** (2013.01 - EP US); **B08B 7/0071** (2013.01 - EP US); **B08B 7/0092** (2013.01 - EP US); **F26B 5/14** (2013.01 - EP US); **B21B 45/0251** (2013.01 - EP US); **B21B 45/0278** (2013.01 - EP US); **B21B 45/0287** (2013.01 - EP US)

Cited by

CN112090808A; CN115585634A; EP4212254A1; CN104801517A; NL2007110C2; CN107537793A; US11559824B2; WO2013009180A1; WO2004000473A1; WO03047729A1; US11420229B2; US11511318B2; US11717850B2; US11717851B2; US11883843B2; US12090511B2; EP3733308B1; EP3733307B1

Designated contracting state (EPC)

DE ES IT

DOCDB simple family (publication)

**EP 1101542 A2 20010523**; **EP 1101542 A3 20020403**; DE 19955066 A1 20010531; DE 19955066 C2 20020124; US 6589357 B1 20030708

DOCDB simple family (application)

**EP 00123293 A 20001027**; DE 19955066 A 19991115; US 71199500 A 20001114